

## DIN-Rail CPU 60

### Eigenschaften:

- i.MX536 SODIMM Prozessormodul
  - Freescale i.MX536 Cortex-A8 CPU
  - 800MHz CPU Clock
  - 512 MByte DDR3-RAM
  - 8 MByte NOR-Flash
  - 4 GByte NAND-Flash
- 2x 12 Bit delta-sigma ADC Input
- 2x 8 Bit DAC Output (0–10V)
- 4x digital Input
- 3x RS485, 1x CAN, 2x RS232
- 1x 10/100 Base-T-Ethernet-Port
- Je 1x UART für Uplink und Downlink
- 1x RS485 über BUS-Connector
- 2x USB Schnittstelle (1x Host, 1x Device)
- Temperaturbereich: -10°C bis +70°C
- Versorgungsspannung: 24V DC
- Hutschienengehäuse: 6TE
- Modulares System, beliebig erweiterbar
- Weitere Hutschienen-Module erhältlich  
z.B. Motorcontroller (9TE), DIN-Rail ADDA 6140 (6TE), DIN-Rail Relais 616S (6TE), DIN-Rail CPU 10 (1TE), DIN-Rail CPU 61 (6TE)
- Alle Module können über UART und RS485 miteinander kommunizieren
- einfache Verbindung der einzelnen Module über passende Busverbinder möglich
- Linux Betriebssystem, BSP mit Toolchain + Quellen werden frei mitgeliefert

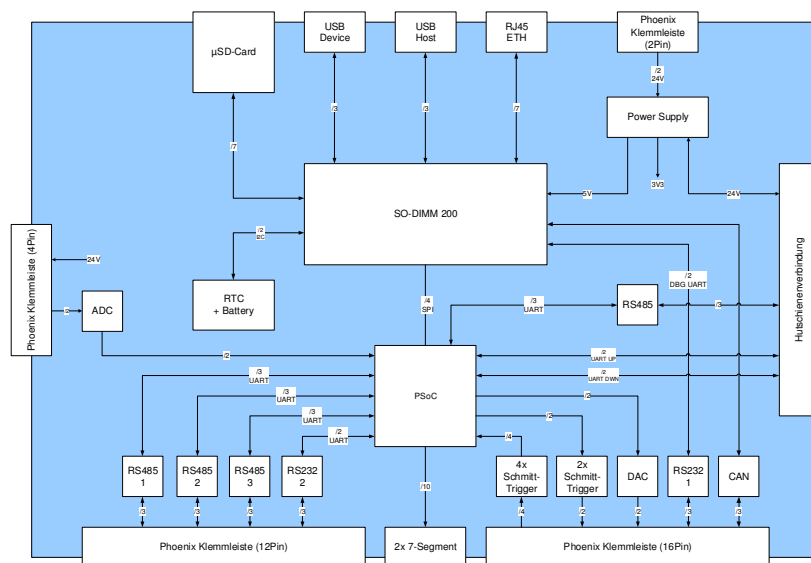


Abbildung 1: Blockschaltbild

## Anschlussbelegung:

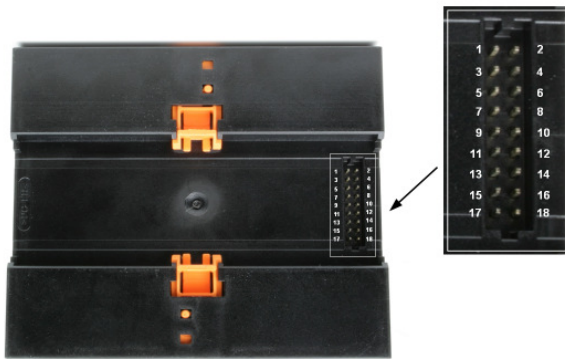


Abbildung 2: Pinbelegung BUS Connector

### BUS-Connector:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1 – NC           | 2 – NC           |
| 3 – +24V         | 4 – +24V         |
| 5 – GND          | 6 – GND          |
| 7 – RS485 A Host | 8 – RS485 B Host |
| 9 – GND          | 10 – GND         |
| 11 – NC          | 12 – NC          |
| 13 – GND         | 14 – GND         |
| 15 – UART4 TXD   | 16 – UART3 RXD   |
| 17 – UART4 RXD   | 18 – UART3 TXD   |



Abbildung 3: Pinbelegung Vorderseite

### J1:

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1 – RS485-A_2 | 7 – RS485-A_1   |
| 2 – RS485-B_2 | 8 – RS485-B_1   |
| 3 – GND       | 9 – GND         |
| 4 – RS485-A_3 | 10 – TX_2 RS232 |
| 5 – RS485-B_3 | 11 – RX_2 RS232 |
| 6 – GND       | 12 – GND        |



Abbildung 4: Pinbelegung Rückseite

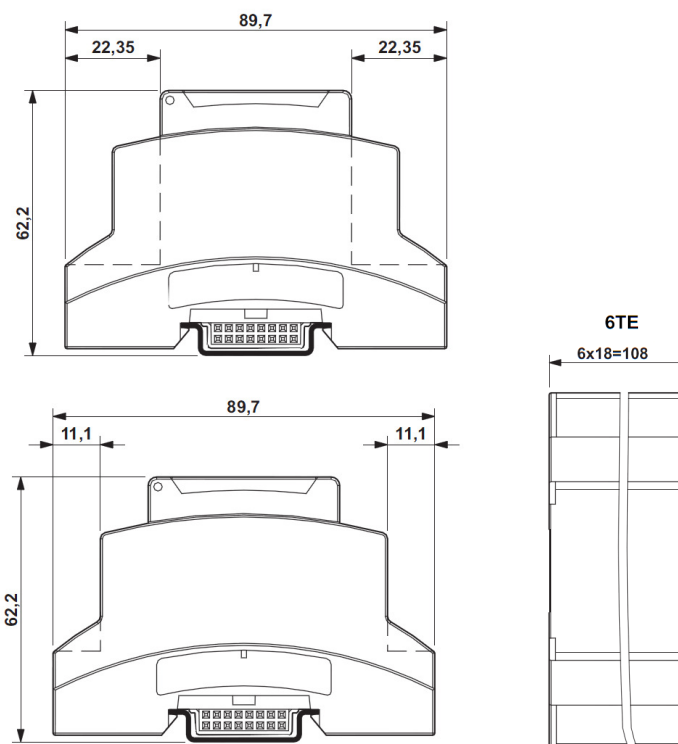
### J2:

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 1 – CAN_L    | 9 – TX_1 RS232 (DBG UART)  |
| 2 – CAN_H    | 10 – RX_1 RS232 (DBG UART) |
| 3 – GND      | 11 – GND                   |
| 4 – DIG_IN_4 | 12 – DIG_OUT_2             |
| 5 – DIG_IN_3 | 13 – DIG_OUT_1             |
| 6 – DIG_IN_2 | 14 – GND                   |
| 7 – DIG_IN_1 | 15 – DAC_OUT_1             |
| 8 – GND      | 16 – DAC_OUT_2             |

## Pinliste i.MX536 SODIMM:

TBD

## Maßzeichnung:



## Kontakt

In-Circuit GmbH  
Königsbrücker Str. 69  
D-01099 Dresden  
www.in-circuit.de  
info@in-circuit.de

| Bestellinformationen  |               |                       |                     |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|
| Beschreibung  | Artikelnummer | Verpackung            | Mindestbestellmenge |
| DIN-Rail CPU 60<br>- i.MX 536 CPU Modul, 6TE                              | 901.249B      | ESD-Tüte, Luftpolster | 1                   |
| DIN-Rail CPU 10<br>- SAM9G45 CPU Modul, 1TE                               | 901.212       | ESD-Tüte, Luftpolster | 1                   |
| DIN-Rail CPU 61<br>- i.MX 536 CPU Modul, 6TE                              | 901.033       | ESD-Tüte, Luftpolster | 1                   |
| DIN-Rail ADDA 6160<br>- 6x ADC Input, 4x DAC Output 0-10V, 6TE            | 901.218       | ESD-Tüte, Luftpolster | 1                   |
| DIN-Rail Relais 616S<br>- 6x Relais Schaltausgang, 4x Digitaleingang, 6TE | 901.214       | ESD-Tüte, Luftpolster | 1                   |
| Busverbinder 1TE 2Slot<br>- zur Verbindung von 1TE Modulen                | 303.061       | ESD-Tüte, Luftpolster | 1                   |
| Busverbinder 6TE 2Slot<br>- zur Verbindung von 6TE Modulen                | 303.062       | ESD-Tüte, Luftpolster | 1                   |
| Micro SD-Karte 1GB<br>- passende µSD-Karte für CPU Module                 | 104.042       | ESD-Tüte, Luftpolster | 1                   |

## Änderungsliste

| Version | Datum      | Änderungsgrund | Bearbeiter |
|---------|------------|----------------|------------|
| A       | 05.09.2013 | Erstausgabe    | Träger     |
|         |            |                |            |
|         |            |                |            |